



MSP-50RF 形

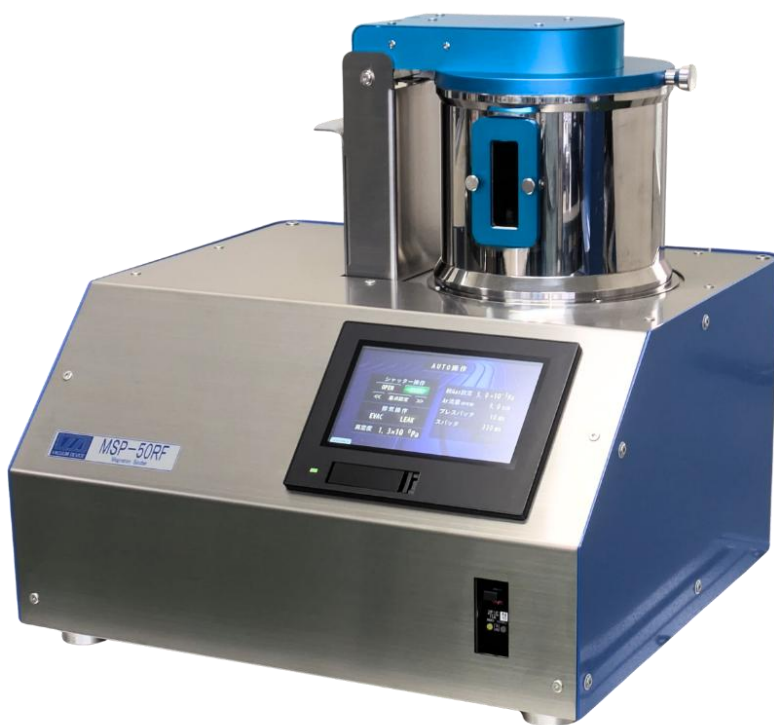
RF スパッタ装置

研究開発用途向け RF スパッタ装置

- この装置はMSP-40Tをベースモデルとした多目的研究開発用途向け RF スパッタ成膜装置です。小形卓上型・省スペース装置です。
- RF 電源により、絶縁物や酸化物などの物質を成膜が可能です。
- 低い電圧でコーティングすると共に試料がフローティング式なので試料損傷を小さく抑えることが出来ます。
- 簡易操作を製品化設計に取り入れ、タッチパネル操作、レシピ機能、シーケンサー制御によるフルオート成膜を実現しました(マッチングの調整は予め必要)。



RF 電源



装置本体

株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

TEL.029-212-7600 FAX.029-212-7601

URL : <https://www.shinkuu.co.jp>

E-mail : device@shinkuu.co.jp

装置の仕様

項目	仕様
電源	AC100V(単相100V15A) アース付き3Pプラグ使用
装置サイズ	幅504mm、奥行486mm、高さ497mm 重量36kg
RF電源サイズ	幅250mm、奥行300mm、高さ140mm
真空排気系	ターボポンプ (TMP) : 67ℓ/sec (装置内蔵チャンバー直結) ダイヤフラムポンプ (DFP) : 16.7ℓ/min (装置外置き・チューブ接続・重量6.5kg)
到達真空度	1×10^{-4} Pa以下
真空度測定	フルレンジ真空計
安全対策	系統別サーキットブレーカ、プログラム制御によるインターロック
操作パネル	タッチパネル式操作ディスプレイ搭載
RF電源	別置きRF電源 最大出力50W 本体装置より電源供給 50W出力のため、高周波設備利用申請の提出が不要です。
タイマー	調整範囲 : 0~999min (1分単位で設定可能)
チャンバーサイズ	内径178mm、深さ159mm ステンレスチャンバー
試料ステージサイズ	直径50mm、アノード電極分離フローティング方式
最大試料サイズ	直径50mm、高さ30mm程度以内
電極—試料台間隔	115mm、95mm、70mm 各試料台付属
ターゲットサイズ	直径25.4mm、厚さ3mm (バックアッププレートを含む)
ターゲット種類	Al ₂ O ₃ 、SiO ₂ 、TiO ₂ 、等 ※Fe、Co等の強磁性物質は利用不可
雰囲気ガス導入	マスフローコントローラによるガス流量自動調整。 アルゴンガス。0.08~0.1MPa。φ1/4インチ接続
ターゲット冷却機構	水冷式ターゲット電極機構。流量スイッチインターロック。 流量1ℓ/min以上。φ6mmチューブ接続。

必須ユーティリティについて

- 冷却水: 流量1ℓ/min以上 本体配管接続φ6mmスウェジロック
水道水又は冷却水循環装置(オプション)が別途必要となります。
- アルゴンガス: 本体入力ガス圧0.08~0.1MPa、本体配管接続φ1/4in スウェジロック
※冷却水循環機、Arガス、減圧弁、継手、チューブはお客様準備品となります。